

Delphilaser

苏州德龙激光股份有限公司
2025年年度报告摘要

2025

股票代码：688170

股票简称：德龙激光

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币25,847,930.53元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币37,885,521.11元。

公司精密激光加工设备业务处于快速扩张阶段，伴随着市场对超快激光器应用需求增长，为配合业务发展，公司资金需求有所增加。近期公司启动了以简易程序向特定对象发行股票方案，募集资金总额不超过 2.4亿元，用于激光器生产建设项目和总部研发中心建设项目，具体内容详见公司分别于2025年12月30日、2026年4月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《苏州德龙激光股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》《苏州德龙激光股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关公告。

结合公司实际情况、发展规划以及未来资金需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	德龙激光	688170	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁凌	洪叶
联系地址	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街98号	
电话	0512-65079108	
传真	0512-65079996	
电子信箱	ir@delphilaser.com	

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

（1）精密激光加工设备

半导体行业：

主要提供硅/碳化硅/砷化镓/钽酸锂/铌酸锂/玻璃等各种晶圆材料的激光划片、晶圆激光开槽、碳化硅晶圆切片、碳化硅激光退火、晶圆激光隐切设备（SDBG）；玻璃通孔（TGV）、激光开槽（low-k）、Edge Trimming、晶圆打标、模组钻孔（TMV）、激光解键合（debonding）、辅助焊接等先进封装应用。

电子行业：

主要提供面向汽车电子及消费电子行业中的玻璃、陶瓷、线路板（FPC/PCB）、薄膜、金属等材料的激光切割、打标、钻孔、蚀刻和焊接等应用。针对折叠屏方向，公司打造了从盖板、碳纤维、金属铰链到 OLED 屏、线路板、自动化的全套解决方案。

锂电行业：

公司面向锂电池制造推出了一系列创新的激光智能化装备，旨在针对下游制程中原有工艺的痛点改善、效率提升和成本降低，产品包括锂电池前段工序解决方案（辊压机激光在线清洗系统、卷对卷激光烘烤设备、立式激光模切分切一体机等）和锂电池中后段激

光解决方案（电芯 UV 喷涂解决方案、三工位激光烘烤模切叠一体机、电芯激光除漆设备等）等；同时，公司重点关注固态电池技术，将压辊清洗、激光烘烤等技术引入到固态电池制程应用，攻克固态电池制程难题，推出极片制痕绝缘、干法电极激光预热、超快激光极片制片等；另外面向锂电池回收梯次利用精细拆解解决方案，推出了激光巴片铣削设备、激光除蓝膜/胶设备、Pack 水冷板自动铣削剥离设备等。

光伏行业：

公司针对钙钛矿薄膜太阳能电池组件提供全套激光以及自动化组件封装解决方案，包括前段 P0 激光打标设备，P1、P2、P3 激光划线设备，P4 激光清边设备、传输&缓存线体、后段封装检测等一系列自动化设备；同时，公司针对 BC 电池方向开发了激光开模、丁基胶打胶等设备；另外针对晶硅/钙钛矿叠层、BIPV 等光伏组件技术正在开发新产品。

显示面板行业：

主要提供用于 TFT-LCD、AMOLED 和 Mini LED 显示屏的切割、修复，以及 Micro LED 晶圆的剥离、转移、修复等产品。

(2) 激光器

公司全资子公司**贝林激光**主要提供纳秒、皮秒、飞秒和可调脉宽等固体激光器、各种光纤激光器及高功率半导体激光器，以及各种激光加工切割头等机械、光学模组解决方案。

(3) 激光加工服务

公司全资子公司**德力激光**及**德昱激光**利用德龙激光的设备及工艺优势，专业提供毫米级、微米级到纳米级的精密激光微加工服务，主要面向 LED、触摸屏、LCD、消费电子、半导体、MEMS、汽车制造、照明和医疗等工业应用，以及各种科技研发，航天航空等领域。

(4) 高精度运动平台

公司子公司**勤研精密**主要提供定制化微纳级运动模组解决方案，根据客户需求，提供全套运动平台及控制模组，包括龙门双驱平台，多轴叠加平台以及高精度单轴模组，服务于电子及半导体生产设备、非标自动化设备、太阳能电池制造装备、检测装备、精密数控机床、高端医疗器械。

(5) 自动化线体

公司子公司**展德设备**面向光通讯行业提供激光切割、钻孔、分板、蚀刻、植球、焊接、硅光芯片键合类激光加工解决方案及自动化点胶装配类、分选类、AOI 检测类、测试类解决方案。同时面向半导体行业、电子行业提供各种自动化生产、检测线体解决方案。

2.2 主要经营模式

公司通过自主研发、生产、销售精密激光加工设备及激光器，并为客户提供激光加工服务实现盈利。公司相关产品及服务主要以直销方式提供，即直接与最终用户签署合同和结算款项，并向其提供技术支持和售后服务。报告期内，公司的主要经营模式未发生变化。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业的发展阶段

根据中国证监会的上市公司行业分类结果，公司归属于“C 制造业”中的子类“C35 专用设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“制造业 (C)”中的“C3569 其他电子专用设备制造”。

根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类 (2018)》，公司所属行业为“高端装备制造产业 (2)”项下的“智能制造装备产业 (2.1)”下的“其他智能设备制造 (2.1.4)”。根据公司具体业务情况，公司所在的细分子行业为激光加工设备制造业。

自 1960 年全球首台激光器问世以来，经过六十余年的技术研发与产业应用，激光加工已成为全球制造业领域的高端前沿技术，被誉为“永不磨损的万能加工工具”。尽管欧美国家在激光领域起步较早，但凭借我国庞大的经济体量、丰富的应用场景以及持续的应用端创新，国内激光加工设备制造业实现了快速发展，逐步打破了欧美企业长期形成的技术与市场垄断格局。持续增长的国内市场需求，为我国激光加工设备企业提供了广阔的发展空间与强劲的增长动力。

(2) 行业基本特点

2024-2026 年，固体超快激光器下游应用增多，部分新型应用逐步从试点研发向规模化量产升级，呈现技术国产化、应用高端化、工艺精细化的行业特点。半导体领域先进制程从实验室验证走向全流程量产，国产厂商持续突破技术难点；电子领域中，超快激光逐步替代机械加工，成为高端 PCB 核心加工方式；新能源领域拓展至前沿材料加工，从锂电池向固态电池领域升级；科研领域向阿秒、量子等前沿方向延伸，整体实现从基础适配到核心环节赋能的跨越，具体行业应用情况如下：

领域	2024 年	2025 年	2026 年
半导体	先进封装实验室验证、SiC/GaN 小批量试产	先进封装试点落地、SiC 规模化导入，超快激光加工良率稳步提升	前道制程与第三代半导体全面量产，国产设备批量进入头部产线，覆盖全流程超快激光加工需求

领域	2024年	2025年	2026年
新能源	晶硅电池、动力电池试点加工，钙钛矿、固态电池工艺研发，超快激光试用于极片切割、电池边缘隔离	光伏/动力电池成熟应用，加工效率与良率大幅提升，覆盖钙钛矿电池微纳结构化	固态电池/氢能拓展，覆盖更多前沿材料加工；锂电池服务市场拓展
电子（PCB板）	传统机械钻孔为主，超快激光试点用于高密度PCB微孔加工，适配高端消费电子需求	超快激光逐步替代机械加工，用于PCB微孔、盲孔、异形槽加工，提升加工精度与效率	超快激光成为高端PCB加工主流方式，覆盖HDI（High Density Interconnect）PCB板、柔性PCB全流程加工，适配5G、汽车电子需求
显示	柔性OLED试产线导入，LLO工艺试点，Micro-LED技术研发阶段	柔性OLED主流化，超快激光成为柔性屏切割标准工艺	Micro-LED巨量转移/剥离需求增长

国家已将激光技术纳入战略性新兴产业核心板块，明确其重点发展路径，通过资金扶持、产学研协同创新等多项政策举措，推动核心技术突破与国产替代进程提速，进一步扩大市场应用规模与覆盖范围。未来，随着下游新兴应用场景不断拓展、国家战略政策持续发力赋能，行业有望实现稳健增长。中国光学学会发布《2026中国激光产业发展报告》显示，2025年，中国激光设备市场销售收入958亿元，同比增长6.8%，在全球占比达58%。预计2026年，增长率将维持在7%左右，市场增长主要来自三大动力：AI催动数据中心和高速通信需求、消费级激光产品放量、进口替代加速，激光加工行业迎来了高质量发展。

(3) 所属行业主要技术门槛

激光产业链各环节均具备相应的技术壁垒，其中激光器制造、光学系统设计与集成的技术壁垒相对更高。激光器制造涉及复杂的制备工艺与精密制造能力，光学系统设计与集成则依赖高精度的光学调校、耦合及系统整合能力。未来随着行业技术持续迭代与成熟，产业链整体技术门槛将有所下降，但核心技术突破与自主可控仍将是驱动行业高质量发展的关键。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1) 激光加工设备行业

公司致力于激光精细微加工领域，凭借先进的激光器技术、高精度运动控制技术以及深厚的激光精细微加工工艺积淀，聚焦于半导体、电子、新能源和面板显示应用领域，为各种超薄、超硬、脆性、柔性及各种复合材料提供激光加工解决方案。经过多年自主研发，公司拥有激光器、激光加工工艺、运动平台、控制软件等一系列核心部件及工艺，掌握了关键核心技术，超快激光

器产品技术先进，应用领域前沿，公司成熟的自产超快激光器显著提升了公司在研发、成本、服务等方面的竞争优势。

激光行业中宏观加工市场规模较大，参与竞争的企业数量较多。激光精细微加工领域技术门槛较高，起步较晚，参与竞争的企业数量较少，特别是高端工业应用激光设备细分市场，国内具备核心竞争力的公司数量进一步减少，公司深耕激光精细微加工领域，技术与产品得到了下游领先企业的一致认可，确立了公司在激光精细微加工行业中的市场地位。

2) 激光器行业

激光器是激光加工设备的核心，也是激光加工设备成本的重要组成部分，掌握激光器核心技术，是降低激光加工设备成本，提升设备竞争力的关键所在。

超快激光器在目前的激光精细微加工领域应用最为广泛。激光器的性能直接影响激光加工设备的品质和使用效果，尤其在超精密加工应用领域，对于激光器的质量和稳定性要求更为苛刻。未来的激光技术将朝着更高功率、更好光束质量、更短波长、更快频率的方向发展，从而带动激光器未来的重点发展方向往短波长、高功率和窄脉宽发展，高聚焦度和短波长意味着激光的作用半径更小，更能够实现精确控制和定点处理，从而为更高精度的工业生产需求提供了可能。

目前国产激光器已经在中低功率激光器市场占据主导地位，皮秒、飞秒等高端超快激光器的销售数量显著提升。随着进口替代的深入与应用场景的不断拓展，据《2026中国激光产业发展报告》显示，2025年我国超快激光器市场规模达到52.2亿元，同比增长14.7%，国产激光器厂商正凭借新一代的高端进口替代产品，积极拓宽市场版图。

公司是国内最早开展DPSS固体激光器研发及产业化的公司之一，于2008年推出了工业级纳秒固体激光器，2010年实现超快激光加工设备的销售，通过十多年的持续技术研发形成了纳秒激光器、超快激光器（皮秒激光器、飞秒激光器）及可调脉宽激光器系列产品，并在固体激光器基础上，于2023年成功研制出光纤激光器，2024年推出高功率半导体激光器，在激光加工精度要求更高的设备上，公司更多使用自产的激光器产品，技术及成本优势明显。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

受益于AI算力需求爆发带来的存储芯片需求增长及锂电池向固态电池产业升级等行业趋势变化，公司精准布局核心应用领域，持续推进技术创新与产品迭代。针对存储芯片领域，公司推出SDBG相关设备，可适配超薄晶圆隐形切割与减薄前加工，助力先进封装工艺升级，已获得国内头部厂商量产订单；在电子制造领域，推出FPC/PCB激光切割&钻孔解决方案，凭借高精度、低损伤优势，赋能电子制造达到新高度；在固态电池领域，研发推出超快激光极片绝缘制痕创新解决方案，同时正在验证激光加热、超快激光制片等新工艺，为固态电池产业升级提供核心技术支撑，进一步拓宽公司产品应用边界，增强核心竞争力；在半导体领域，针对第四代半导体金刚石推出激光剥离分片创新解决方案，拓宽激光应用领域。具体产品情况如下：

1) 实现功率芯片向存储芯片领域突破，打造超薄芯片切割新标杆——德龙激光 SDBG 先进工艺

随着 AI 算力需求爆发，存储技术向高密度、轻薄化升级，随着半导体封装技术迈向 2.5D 与 3D 集成化方向，芯片厚度不断减薄，单片功能密度显著提升。传统刀片切割在应对超薄晶圆时易出现崩边、隐裂、颗粒污染等问题，严重影响后续封装良率。于是，SDBG (Stealth Dicing Before Grinding) 技术应运而生。其工艺流程为：先利用激光在晶圆内部预设隐形改质层→再进行背面减薄研磨→晶圆在应力作用下自动分离成单芯片。这种方式不仅避免了对超薄晶圆的机械应力影响，也显著减少了崩边与微裂纹，实现更高良率、更清洁的分割效果。因此，SDBG 技术正成为 3D NAND、DRAM、CIS 及高端逻辑芯片等领域的主流制程方案。

德龙激光推出自主研发的硅晶圆激光隐切设备。该设备针对 12 英寸硅存储芯片研发，全面支持 SDAG (Stealth Dicing After Grinding) 与 SDBG 工艺，特别适用于厚度 35~85 μm 的超薄晶圆隐切与减薄前加工，是先进封装制程中不可或缺的关键装备。设备已获得存储芯片国内头部厂商的首个国产量产订单，项目已通过客户端量产验证，后续将持续优化并逐步扩大应用规模。

2) 德龙激光赋能电子制造新高度——PCB&FPC 激光切割钻孔解决方案

i. 行业背景：算力驱动下的精密加工挑战

随着 AI 服务器算力需求指数级增长，HDI 板向更高层数 (20 层以上)、更细线宽/间距 (30 μm /30 μm 以下)、更小微盲孔孔径 ($\leq 50\mu\text{m}$) 方向演进，IC 封装载板对钻孔精度、孔壁质量、位置公差的要求亦提升至全新高度。传统机械钻孔在加工高多层 HDI 及封装载板时面临钻头磨损快、孔位偏差大、内层焊盘破坏、钉头过大等瓶颈，难以满足先进封装及高密度互连的严苛标准。激光钻孔凭借非接触、高精度、小热影响区的核心优势，成为 AI 算力基板与 IC 载板微盲孔、通孔加工的主流方案。

与此同时，在 PCB 分板、外形切割及 FPC (柔性电路板) 加工领域，传统冲切与机械铣削存在毛刺大、粉尘多、应力损伤、刀具损耗高等问题，尤其对于超薄 FPC、高频软板、刚挠结合板等精密部件，传统方式难以保证边缘质量与尺寸一致性。激光切割以其无接触、热影响区小、切缝窄、可加工异形复杂轮廓等优势，正快速替代传统工艺，成为 PCB&FPC 精密加工的关键技术。

针对不同基板材料特性，德龙激光科学匹配 CO₂ 激光、UV 激光、超快激光 (皮秒/飞秒) 光源与工艺参数，实现了对 AI 服务器 HDI 高频材料 (如 M7、M8、M9 及 Q 布)、IC 载板 ABF 膜、陶瓷基板、BT 树脂等高端基板的精准微孔加工，同时为 PCB 硬板、FPC 柔性板、覆盖膜、软硬结合板等提供高精度、高良率的激光切割与钻孔一体化解决方案，全面保障信号完整性与电气可靠性。

ii. 核心技术：面向 PCB&FPC 的全栈激光加工体系

针对 AI 服务器 HDI PCB 板、IC 封装载板、陶瓷复合基板、多层 PCB、FPC 及刚挠结合板等不同产品的孔径、深度、外形轮廓及材料要求，德龙激光已形成从超快激光精细钻孔、紫外激光精密切割到超快激光冷加工的全栈技术能力。

1. PCB 激光切割与钻孔方案

- PCB 外形切割与分板：采用紫外或绿光激光，实现无接触、无应力、无毛刺的高精度切割，适用于 FR-4、高频高速板（M7/M8/M9）、金属基板等材料。切割边缘光滑，碳化极小，可满足航空航天、汽车电子、AI 服务器等高标准要求。

- PCB 精密钻孔：根据层数厚度与材质和孔径要求，选择超快激光/CO₂ 激光/超快+CO₂ 复合激光工艺等，可实现 >30μm 微孔盲孔批量加工，应对多层陶瓷复合 AI 服务器基板，也可实现深径比 >12:1 的精密直通孔加工，解决传统机械钻孔难以加工硬脆材料的问题。

2. FPC 激光切割、钻孔与成型方案

- FPC 外形切割与揭盖：针对柔性覆盖膜、聚酰亚胺（PI）基材、LCP 基板等，采用超快紫外激光或绿光激光，实现高速度、低热影响的异形切割，无熔融残留，折弯区域无裂纹。

- FPC 钻孔（通孔/盲孔）：利用紫外激光配合 AOD 声光偏转加工技术，配合 IFOV 无限视野多轴联动技术，在 FPC 上实现直径 ≥20μm 的盲孔/通孔高速加工，满足高密度互连与可穿戴设备微小化需求。

- 覆盖膜开窗：精准控制激光能量，只剥离覆盖膜而不伤及铜箔，精准控深刻蚀，减少传统 SM 印刷曝光显影清洗等制程，良率提升至 99% 以上。

iii. 方案优势

- 一机多能：同一平台可灵活配置不同波长激光源，实现切割、钻孔、开窗等多工艺集成。
- 高精度与高良率：视觉定位系统+直线电机驱动，加工精度 ≤±5μm，综合良率 ≥99%。
- 广泛材料适应性：覆盖 FR-4、高频高速材料、PI、LCP、陶瓷、ABF 膜、BT 树脂等。
- 智能化生产：支持 MES 对接，具备自动涨缩补偿、自动化搬运、全流程数据追溯功能。

iv. 应用场景

- AI 服务器 HDI 板、背板、高速多层板的切割与微盲孔/通孔加工
- 5G 通信模块、光模块中高频 PCB 的精密分板与金手指斜边切割
- 智能手机、可穿戴设备中 FPC 软板的外形切割、揭盖、补强贴合及微孔钻孔
- IC 封装载板、存储芯片载板的超快激光钻孔与轮廓切割
- 刚挠结合板、Mini LED 基板的激光加工

德龙激光将持续围绕 PCB&FPC 行业日益严苛的精度、效率与可靠性需求，以领先的激光切割钻孔技术，助力电子制造迈向新高度。

3) 超快激光赋能固态电池——固态电池绝缘、制片、加热全系列超快激光创新解决方案

固态电池凭借高能量密度、高安全性、长循环寿命、宽温域，被视为下一代电池的核心方向。固态电池为解决固固界面接触问题需要预加 MPa 量级压强，极片边缘胶框绝缘成为新增必备关键

制程；固态电池固固界面结构叠片工艺成为必然选择，同时硅碳/锂金属负极、固态电解质等新型介质材料的引入，对极片制片带来挑战，超快激光具有热影响小、加工精度高、材料适应度高等优势，是固态电池制片加工的最优选择；固态电池对于溶剂残留极致苛刻要求，对干燥制程提出更高要求，激光加热干燥技术具有效率高、能耗低、占地面积小等优势，具有广阔的应用前景。针对固态电池以上制程痛点，公司基于高功率超快激光技术、万瓦级激光及大尺寸匀光整形技术，面向固态电池制痕绝缘、极片制片、加热干燥提出创新的激光解决方案。

关于固态制痕绝缘技术，公司首创了超快激光精细蚀刻+打印 UV 绝缘胶层固化技术，同时满足绝缘胶层精度控制和绝缘胶层稳定性，实现 500W 量级的超快激光器自研；依托于自研 500W 超快激光器延伸应用于硅碳/锂金属负极、固态电解质等多层复合介质的极片高效精细制片，抑制制片过程中的毛刺、熔珠、热蔓延等难题，完成频率、功率、脉冲串模式自适应控制功能开发，适用于多层介质异形轨迹精细化切割；关于激光加热干燥技术，完成 50KW 高功率激光器自研、1.8m 大宽幅光斑 95%匀化设计及光学系统开发、 $\pm 1^\circ\text{C}$ 精度毫秒级实时动态温度闭环控制技术，可高效去除极片内游离水和结合水，快速将溶剂含量控制在 50ppm 以内。

4) 超快激光赋能第四代半导体——金刚石激光剥离分片创新解决方案

金刚石凭借超高导热、高击穿场强、高载流子迁移率，成为下一代功率与射频半导体的关键衬底材料。但其极高硬度与脆性，导致传统线切、砂轮切割存在损耗大、损伤深、良率低等痛点，严重制约产业化应用。

德龙激光采用超快激光隐形改性技术，实现金刚石衬底低损伤、高效率剥离分片，完整流程精准可控，为金刚石衬底规模化应用提供关键支撑

对比传统切割工艺，金刚石剥离方案具备以下核心优势：

- 零损伤加工：超快激光冷加工特性，避免表面损伤，保证衬底力学与电化学性能；
- 极低损耗：改质层极薄，材料损耗少，显著提升大尺寸晶锭出片率。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	1,772,335,122.46	1,834,177,292.67	-3.37	1,744,988,810.40
归属于上市公司股东的净资产	1,257,517,716.22	1,232,346,686.30	2.04	1,307,397,428.27
营业收入	787,447,238.05	715,191,631.87	10.10	581,808,798.56
利润总额	29,982,997.63	-5,328,797.72	不适用	30,143,165.91
归属于上市公司股东的净利润	25,847,930.53	-34,501,101.02	不适用	39,051,094.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,350,886.01	-51,495,302.67	不适用	25,193,150.79
经营活动产生的现金流量净额	49,564,670.92	-48,577,499.15	不适用	-5,631,030.57
加权平均净资产收益率(%)	2.08	-2.73	增加4.81个百分点	2.99

基本每股收益（元/股）	0.25	-0.33	不适用	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.25	-0.33	不适用	0.38
研发投入占营业收入的比例（%）	16.33	18.24	减少1.91个百分点	17.82

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	99,165,075.14	186,050,459.10	166,179,049.80	336,052,654.01
归属于上市公司股东的净利润	-16,470,410.56	986,048.08	-1,377,446.16	42,709,739.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-19,917,674.26	-4,423,743.00	-6,531,697.38	37,224,000.65
经营活动产生的现金流量净额	20,943,240.54	-1,290,424.90	-11,314,510.64	41,226,365.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							8,631
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							11,813
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							-
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							-
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							-
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
赵裕兴	-1,883,600	21,861,400	21.15	0	无	0	境外自然 人
北京沃衍投资中心 (有限合伙)	-1,727,637	8,299,200	8.03	0	无	0	境内非国 有法人
陈江	-122,300	5,167,800	5.00	0	无	0	境内自然 人
无锡冠赢投资有限 公司	-450,000	3,240,000	3.13	0	无	0	境内非国 有法人

苏州德展投资管理中心（有限合伙）	-1,033,511	1,690,457	1.64	0	无	0	境内非国有法人
江苏中煤矿山设备有限公司	-722,351	1,644,937	1.59	0	无	0	境内非国有法人
孙复娣	1,564,769	1,564,769	1.51	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—工银瑞信圆兴混合型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	1.45	0	无	0	境内非国有法人
北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—江阴沃衍投资中心（有限合伙）	-483,163	1,100,000	1.06	0	无	0	境内非国有法人
姚骅	1,033,600	1,033,600	1.00	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京沃衍投资中心（有限合伙）、北京沃衍资本管理中心（有限合伙）—江阴沃衍投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

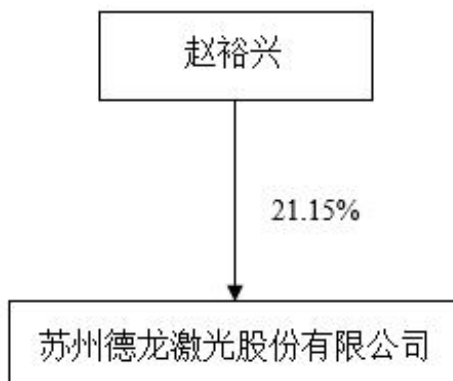
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

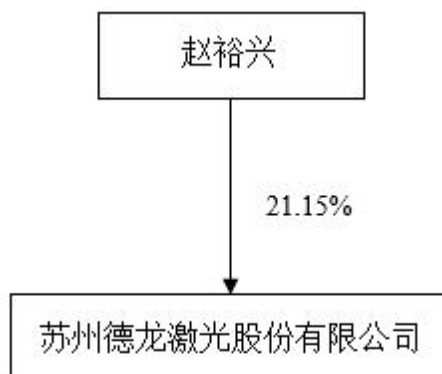
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用